

评级：增持（维持）

分析师：王芳

执业证书编号：S0740521120002

Email: wangfang02@zts.com.cn

分析师：杨旭

执业证书编号：S0740521120001

Email: yangxu01@zts.com.cn

研究助理：赵晗泥

Email: zhaohn01@zts.com.cn

研究助理：游凡

Email: youfan@zts.com.cn

研究助理：李雪峰

Email: lixf05@zts.com.cn

基本状况

上市公司数	288
行业总市值(百万元)	3,958,079
行业流通市值(百万元)	2,080,930

行业-市场走势对比

相关报告

【中泰电子】半导体周跟踪：行业复工复产有序推进，业绩有望成为最大催化

【中泰电子】半导体周跟踪：功率材料提价，供需持续紧张看好半导体业绩高增长

【中泰电子】半导体周跟踪：车规级芯片缺货依旧，国产模拟进入黄金期

重点公司基本状况

简称	股价 (元)	EPS				PE				PEG	评级
		2019	2020	2021	2022E	2019	2020	2021	2022E		
韦尔股份	160	0.5	3.1	5.1	6.9	298	51	31	23	0.7	买入
兆易创新	131	1.9	1.9	3.5	4.8	69	70	38	27	0.7	买入
圣邦股份	256	2	1.8	2.9	3.9	151	139	88	66	1.9	买入
时代电气	59	2	2.1	1.6	2.0	26	28	37	29	1.0	买入
士兰微	46	0	0.1	0.7	0.9	4138	892	68	53	1.9	买入
立昂微	60	0	0.5	0.9	1.4	170	120	68	42	0.7	买入
江丰电子	24	0	0.0	0.1	0.1	NA	683	450	286	5.0	买入
北方华创	257	1	1.1	2.0	3.2	407	237	126	81	1.5	买入
兴森科技	10	0	0.6	0.4	0.5	52	29	25	20	15.9	买入

投资要点
■ 板块持续震荡，国产替代仍是主旋律

本周（2022/06/13-2022/06/17）市场整体上涨，沪深300指数上涨1.7%，上证综指上涨0.7%，深证成指上涨2.5%，创业板指数上涨3.9%，中信电子上涨0.4%，半导体指数下降0.4%。其中：1）半导体设计跌2.4%（存在个股行情，其中上海贝岭上涨15%、博通集成上涨13%、希荻微上涨8%、其他公司涨跌幅在-4%~+6%之间），2）半导体制造跌0.7%，3）半导体封测涨2.6%，4）半导体材料涨0.1%（行情存在分化，中晶科技+19%、江丰电子+5%、神工股份-8%，其他公司涨跌幅在-4%~4%之间），5）半导体设备跌4.4%（存在个股行情，其中晶盛科技上涨6%、万业企业上涨4%、其他公司跌幅在0%~8%），6）功率半导体跌0.7%（行情存在分化，捷捷微电+8%、新洁能上涨6%、扬杰科技-4%、时代电气-4%，其他公司涨跌幅在+5%~2%之间）。

上周电子板块持续震荡，少数标的走出个股行情，板块持续震荡主要是市场对景气度存在担忧。我们认为，景气度下行下，龙头公司在去年借助窗口期切入供应链后，今年仍将持续提升份额，国产替代仍是主旋律。

■ 行业新闻

1) 国内5月半导体产量略升。国家统计局(NBS)最新数据，5月国内IC生产量回升至275亿颗，较4月的259亿颗产量月成长6%以上，不过国内5月IC产量仍低于3月的285亿颗，反映出部分地区疫情封控措施的影响持续存在，但本土半导体产量略有回温，凸显整体经济正趋于好转迹象。即使国内5月IC产量较疫情封控影响对特别是上海、长三角地区制造业活动最明显的4月有所回温，但与2021年同期IC产量相比，仍年减达10.4%。2021年5月国内IC产量达到298亿颗，年增达37.6%。

2) 全球晶圆厂设备支出将达1090亿美元，中国大陆占比15.6%。

近日，国际半导体产业协会(SEMI)发布最新季度预测报告称，预计2022年全球晶圆厂设备支出将同比增长20%，达到1090亿美元，创下历史新高。这是继2021年激增42%之后，全球半导体设备支出连续第三年大幅增长。SEMI预计，2023年全球晶圆厂设备投资预计仍将保持强劲。从区域来看，中国台湾地区的半导体设备投资额预计同比增长52%至340亿美元，占比31.2%；韩国半导体设备支出为255亿美元，同比增长7%，占比23.4%；中国大陆半导体设备支出为170亿美元，同比下滑14%，占比15.6%；欧洲/中东地区的半导体设备支出将达到创纪录的93亿美元，虽然相对于其他地区的投资规模较小，但其投资规模将实现同比176%的惊人增长。

3) 传长江存储将跳过192层，年底量产232层NAND。

6月14日消息:长江存储将跳过原定192层NAND,直接挑战232层NAND,并有望于2022年底量产。2021年长存128层NAND量产,5月有长存已向一些客户交付192层NAND样品,预计2022年底前正式推出。从堆叠层数看,今年5月,美光发布首款232层NAND,并预计今年年底量产,三星预计在今年年底推出200+层的NAND,铠侠目前制程停留在112层,预计2022年底前量产162层;若长存在年底量产232层NAND,将缩小一代制程差距,成功追上国际大厂。

■ 重要公告

士兰微: 公司拟通过控股子公司成都士兰半导体制造有限公司(以下简称“成都士兰”)投资建设“年产720万块汽车级功率模块封装项目”,项目总投资为30亿元。根据成都士兰财务部初步测算,本项目达产后预计新增年销售收入(不含税)277,168万元,新增年利润总额30,769万元,内部收益率(税后)为14.3%,静态投资回收期(含建设期)为5.3年。

■ **投资建议:** 持续推荐半导体行业具有大空间/高景气度板块领先企业。

1) 功率: 下游新能源拉动的需求高景气仍将持续,建议关注扬杰科技、时代电气、斯达半导、士兰微、新洁能、宏微科技等;

2) 模拟: 龙头厂商料号稳步拓展、持续受益于国产化,建议关注圣邦股份、思瑞浦、希荻微等;

3) MCU: 看好龙头通过产品结构调整+国产化持续实现业绩高增长,建议关注兆易创新、中颖电子等;

4) 材料: 下游需求火热,国产厂商在下游客户验证周期加快,建议关注立昂微、江丰电子、沪硅产业、兴森科技、安集科技等;

5) 设备: 晶圆厂进入开支高峰期,拉动上游设备需求,建议关注北方华创、芯源微、华峰测控、中微公司、拓荆科技等。

■ **风险提示:** 需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。

内容目录

一、行情回顾：市场整体上涨，半导体指数下跌 0.4%	- 4 -
二、行业新闻：国内 5 月半导体产量略升，疫情缓解经济回温	- 7 -
三、板块跟踪：板块持续震荡，国产替代仍是主旋律	- 11 -
四、重要公告：士兰微拟投资 30 亿元汽车级功率模块封装项目	- 13 -
五、投资建议	- 13 -
六、风险提示	- 14 -

一、行情回顾：市场整体上涨，半导体指数下跌 0.4%

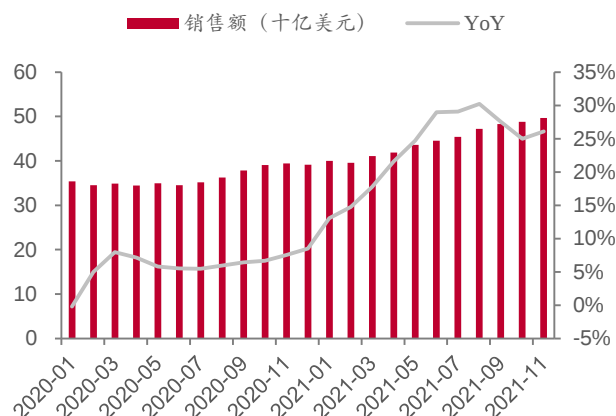
- 当周(2022/06/13-2022/06/17)市场整体上涨,沪深300指数上涨1.7%,上证综指上涨0.7%,深证成指上涨2.5%,创业板指数上涨3.9%,中信电子上涨0.4%,半导体指数下跌0.4%。其中:半导体设计跌2.4%、半导体制造跌0.7%、半导体封测涨2.6%、半导体材料涨0.1%、半导体设备跌4.4%、功率半导体跌0.7%。
- 当周(2022/06/13-2022/06/17)费城半导体指数下跌,跌幅为8.9%,2022/01/01-2022/06/17跌幅为34.7%。台湾半导体指数周跌6.5%,2022/01/01-2022/06/17跌幅为21.3%。

图表1: 费城半导体指数



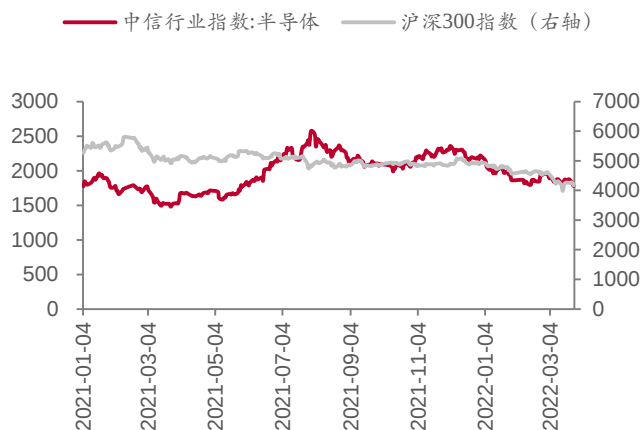
来源: wind, 中泰证券研究所

图表2: 全球半导体月度销售额及增速



来源: wind, 中泰证券研究所

图表3: A股半导体指数



来源: wind, 中泰证券研究所

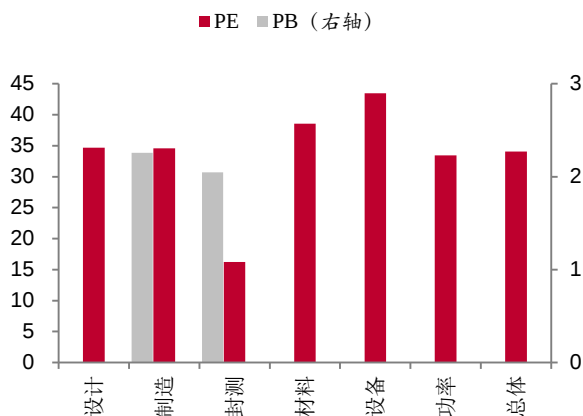
图表4: 中国台湾半导体指数



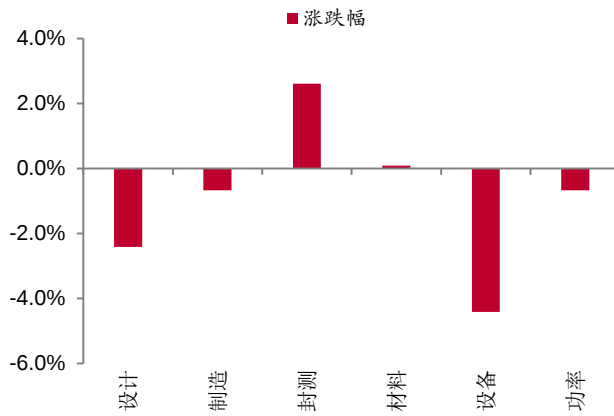
来源: wind, 中泰证券研究所

图表5: 细分板块估值情况 (2022)

图表6: 本周半导体各细分板块涨跌幅情况



来源: wind, 中泰证券研究所

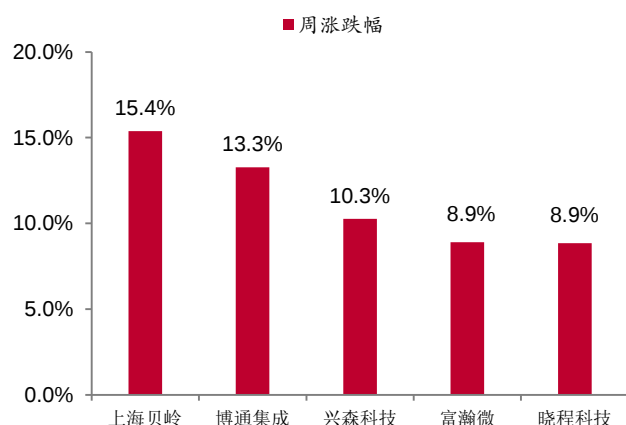


来源: wind, 中泰证券研究所

注: PE=最近市值/2022 年 wind 一致预期净利润

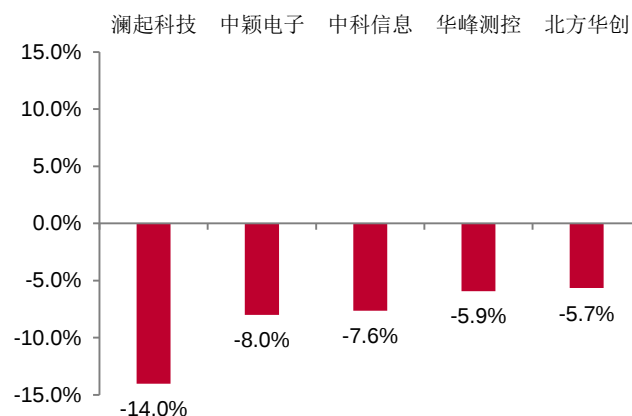
注: PB=最近市值/2022 年 wind 一致预期净资产

图表 7: 上周半导体行业涨跌幅前五公司



来源: wind, 中泰证券研究所

图表 8: 上周半导体行业涨跌幅后五公司

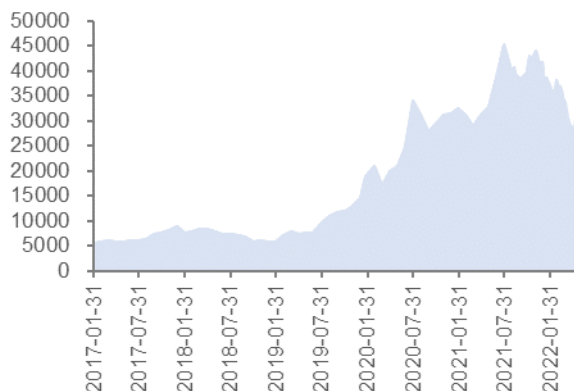


来源: wind, 中泰证券研究所

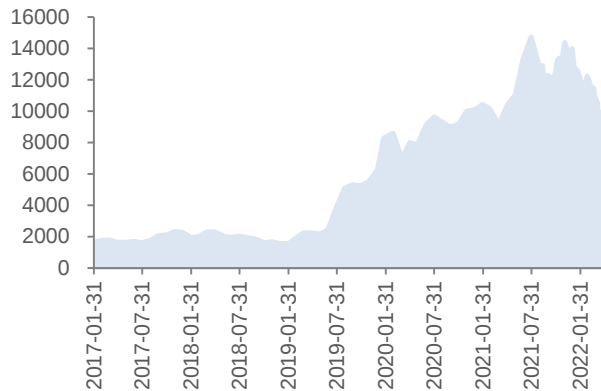
- 截至 6 月 17 日, A 股半导体公司总市值达 32389 亿元, 环比跌 1.0%。其中: 设计板块公司总市值 9656 亿元, 环比跌 1.7%; 制造板块公司总市值 5970 亿元, 环比跌 0.7%; 设备板块公司总市值 4104 亿元, 环比跌 1.9%; 材料板块公司总市值 4234 亿元, 环比涨 1.0%; 封测公司总市值 1445 亿元, 环比涨 1.9%; 功率板块总市值 7389 亿元, 环比跌 1.5%。

图表 9: A 股半导体板块公司总市值 (亿元)

图表 10: A 股半导体设计板块公司总市值 (亿元)

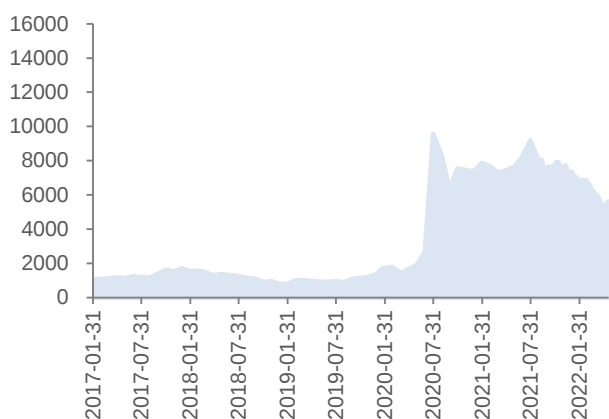


来源: wind, 中泰证券研究所



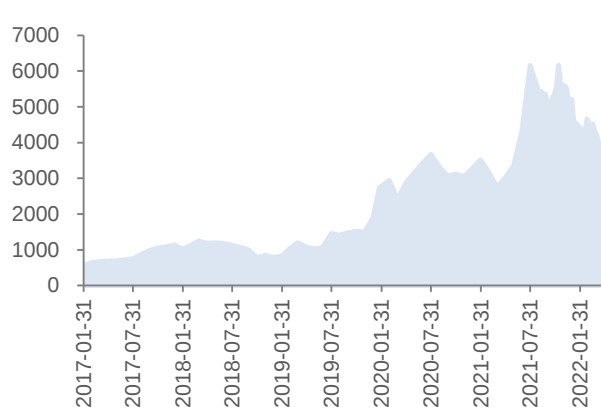
来源: wind, 中泰证券研究所

图表 11: A 股半导体设备制造公司总市值 (亿元)



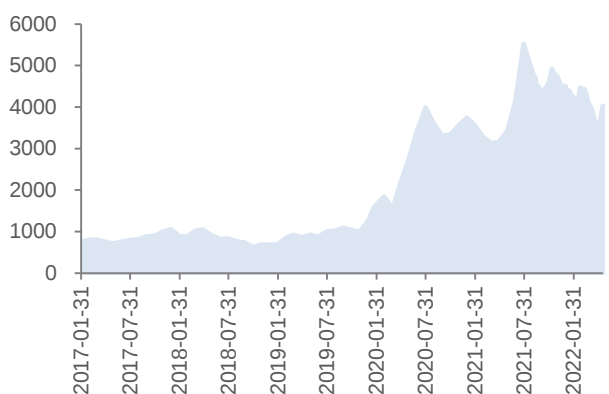
来源: wind, 中泰证券研究所

图表 12: A 股半导体设备板块公司总市值 (亿元)



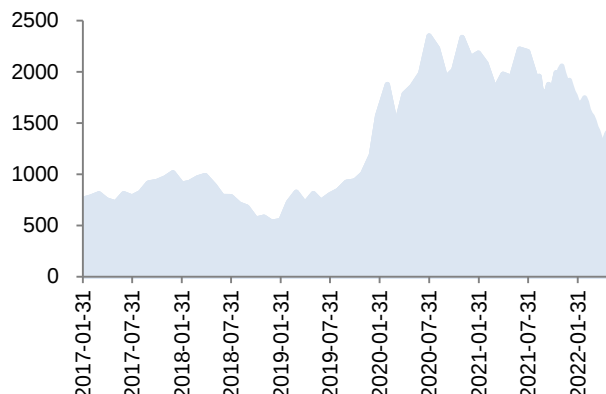
来源: wind, 中泰证券研究所

图表 13: A 股半导体材料板块公司总市值 (亿元)



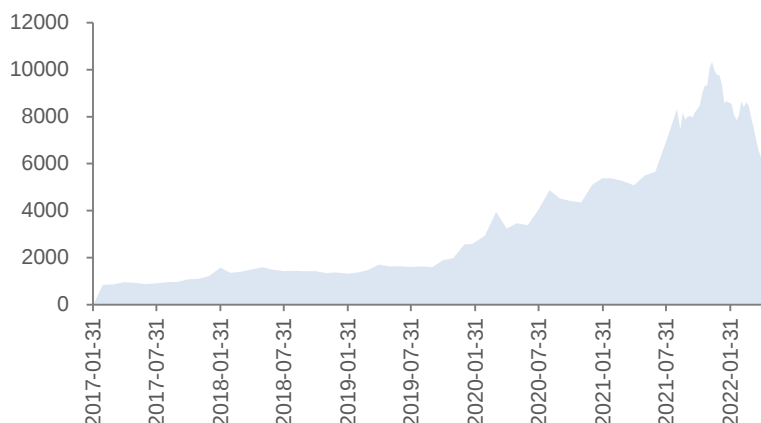
来源: wind, 中泰证券研究所

图表 14: A 股半导体封测板块公司总市值 (亿元)



来源: wind, 中泰证券研究所

图表 15: A 股功率板块公司总市值 (亿元)



来源：中泰证券研究所

- 当周（2022/06/13-2022/06/17）沪/深股通总体增持半导体板块。沪/深股通持股市值前 20 的企业中，13 家企业获增持，7 家企业被减持。增持金额前三公司为北方华创（5.17 亿元）、斯达半导（3.06 亿元）、中微公司（2.46 亿元），减持金额前三公司为士兰微（-2.37 亿元）、闻泰科技（-1.59 亿元）、澜起科技（-0.89 亿元）。

图表 16：沪/深股通半导体板块持仓情况（按持股市值排名）

本周排名	上周排名	证券代码	证券简称	一周增减持金额 (百万元)	一月增减持金额 (百万元)	年初至今增减持金额 (百万元)	沪(深)股通持股市值 (百万元)	沪(深)股通持股占自 由流通股比例 %
1	1	603501.SH	韦尔股份	75	-567	-459	10,487	14
2	2	002371.SZ	北方华创	517	416	-72	6,734	11
3	4	002129.SZ	中环股份	159	580	-31	6,293	5
4	3	002008.SZ	大族激光	134	-300	165	5,934	23
5	6	300316.SZ	晶盛机电	34	-24	-794	4,585	13
6	5	603290.SH	斯达半导	306	1,001	1,655	4,318	21
7	9	688012.SH	中微公司	246	587	2,091	4,158	10
8	7	600745.SH	闻泰科技	-159	-881	501	3,830	9
9	8	603986.SH	兆易创新	-76	-536	-3,083	3,808	5
10	11	002049.SZ	紫光国微	-10	-374	-194	3,440	4
11	10	300661.SZ	圣邦股份	80	-160	-19	3,270	12
12	12	300782.SZ	卓胜微	32	80	-706	3,123	8
13	13	688008.SH	澜起科技	-89	-180	-315	1,767	5
14	14	600460.SH	士兰微	-237	-830	251	1,676	5
15	15	600584.SH	长电科技	-20	172	75	1,427	4
16	16	300373.SZ	扬杰科技	90	16	-380	1,211	5
17	18	002180.SZ	纳思达	-46	32	-47	1,131	4
18	19	688099.SH	晶晨股份	69	183	653	1,020	3
19	17	300327.SZ	中颖电子	104	6	-43	990	8
20	20	600206.SH	有研新材	92	110	258	983	9

来源：wind，中泰证券研究所

注：此表中沪（深）股通持股市值=沪（深）股通持股数量*上周交易均价，数据更新截止于 2022/6/17；

二、行业新闻：国内 5 月半导体产量略升，疫情缓解经济回温

■ 1、国内 5 月半导体产量略升 疫情缓解 经济回温

据国家统计局（NBS）最新数据，5 月国内 IC 生产量回升至 275 亿颗，较 4 月的 259 亿颗产量月成长 6%以上，不过国内 5 月 IC 产量仍低于 3 月的 285 亿颗，反映出部分地区疫情封控措施的影响持续存在，但本土半导体产量略有回温，凸显整体经济正趋于好转迹象。

即使国内 5 月 IC 产量较疫情封控影响对特别是上海、长三角地区制造业活动最明显的 4 月有所回温，但与 2021 年同期 IC 产量相比，仍年减达 10.4%。2021 年 5 月国内 IC 产量达到 298 亿颗，年增达 37.6%。

新闻链接：

<https://gb-www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?cnlid=1&id=00006376>

[63_2zv7ph8z53az9r4ybon4g&wpidx=5](#)

■ 三星李在镕会晤荷兰首相商请协调 ASML 供货 EUV

三星在半导体积极布局,根据韩媒报导,三星电子负责人李在镕本周与荷兰首相 Mark Rutte 进行会晤,报导称,两人主要讨论加强半导体产业合作、解决全球供应链问题等。此外,李在镕特别谈到 ASML 的极紫外光 (EUV) 设备,请求 Rutte 帮助三星协调 EUV 设备供货问题。李在镕之后还将拜访 ASML 总部,进一步接洽相关事宜,三星之前曾表示,将争取其订购的 EUV 机台尽早到货,助其在先进制程竞争中获得优势。

新闻链接:

<https://tw.appledaily.com/property/20220615/3A4CFA95705E0832A7D1DBEA7A>

■ 台积电 N2 技术 2025 年量产、总产能将扩大 50%

台积电 17 日举办 2022 年北美技术论坛,会中揭示先进逻辑技术、特殊技术、以及三维集成电路 (3D IC) 技术的最新创新成果。首度推出采用纳米片电晶体的下一代先进 N2 制程技术,以及支持 N3 与 N3E 制程的 TSMC FINFLEX 技术。台积电 N2 技术和 N3 技术相比,功效大幅往前推进。在相同功耗下,速度增快 10~15%,或在相同速度下,功耗降低 25~30%。台积电表示,N2 将采用纳米片晶体管架构,在性能和功率效率方面提供全节点改进,以支持台积电客户的下一代产品创新。除了移动计算基准版本之外,N2 技术平台还包括一个高性能变体,以及全面的小芯片集成解决方案。N2 计划于 2025 年开始生产。

除了展示先进技术外,台积电并透露了其他重要信息,包括 2024 年将拥有 ASML 下一代芯片制造工具以及到 2025 年,其成熟和专业节点的产能将扩大约 50%。

新闻链接: <https://www.163.com/dy/article/HA2OCU7Q0511RIVP.html>

■ 3M 比利时冷却剂停工冲击

据中国台湾电子时报报道,最近韩国业界传出消息,3M 比利时工厂被传批准重启,仍造成半导体冷却剂的供应陷入恐慌,三星电子 (Samsung Electronics)、SK 海力士 (SK Hynix) 决定多元化供应商。外传三星、SK 海力士急寻替代业者,同时将目光转向国内。三星、SK 海力士最快 2022 年底前,将可望解决冷却剂的供应不稳定,实现供应商多元化。冷却剂主要用于半导体蚀刻,攸关产品生产良率。三星、SK 海力士过去主要向 3M 采购,全球 9 成半导体冷却剂皆仰赖 3M。

新闻链接: <http://stock.10jqka.com.cn/20220616/c639827209.shtml>

■ 全球晶圆厂设备支出将达 1090 亿美元,中国大陆占比 15.6%

近日,国际半导体产业协会 (SEMI) 发布最新季度预测报告称,预计 2022 年全球晶圆厂设备支出将同比增长 20%,达到 1090 亿美元,创下历史新高。这是继 2021 年激增 42% 之后,全球半导体设备支出连续第三年大幅增长。SEMI 预计,2023 年全球晶圆厂设备投资预计仍将保持强劲。

从区域来看,中国台湾地区的半导体设备投资额预计同比增长 52% 至 340 亿美元,占比 31.2%;韩国半导体设备支出为 255 亿美元,同比增长 7%,占比 23.4%;中国大陆半导体设备支出为 170 亿美元,同比下滑 14%,占比

15.6%；欧洲/中东地区的半导体设备支出将达到创纪录的 93 亿美元，虽然相对于其他地区的投资规模较小，但其投资规模将实现同比 176%的惊人增长。

新闻链接：<https://view.inews.qq.com/a/20220615A02E7S00>

■ 华为发布新一代 40kW 直流充电模块

华为数字能源在世界电动车大会（EVS35）上发布新一代可靠、低噪、高效的智能充电 40kW 直流充电模块，旨在为电动充电基础设施打造优质“内核”。该充电模块不仅能有效提升车主充电体验，还能减少运维成本，提升桩企和运营商的运营效益。该充电模块采用创新的全灌胶、全隔离工艺，在恶劣环境下也能长时间可靠运行，并支持智能运维提醒和 OTA 远程升级。在本次活动上，华为数字能源还展示了适合住宅场景、采用光、储、充一体化架构的用户充电解决方案。

新闻链接：

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1735656768040650407&wfr=spider&for=pc>

■ AMD 芯片定制，向第三方 Chiplet 打开大门

随着 AMD 起航以制造更符合客户喜好的产品，AMD 开始使用芯片。这家芯片制造商详细介绍了模块化芯片的未来，客户可以在定制芯片封装中混合和匹配非 AMD 处理器。AMD 首席技术官 Mark Papermaster 在上周晚些时候的分析师会议上表示：“我们专注于让芯片更容易实现更灵活。”AMD 将允许客户在紧凑的芯片封装中实现多个裸片（也称为小芯片或计算块）。AMD 已经在使用磁贴，但现在欢迎第三方制造加速器或其他芯片，以将其与 x86 CPU 和 GPU 一起包含在 2D 或 3D 封装中。

AMD 多年来一直在定制芯片，最著名的是为索尼和微软制造的游戏机，但主要使用内部技术。AMD 高管在展会期间表示，客户希望灵活地满足特定的组织要求，并希望将加速器集成到包括人工智能和汽车在内的应用程序的芯片中。“我们将使向该小芯片平台添加第三方 IP 和客户 IP 变得更加容易，”AMD 首席执行官 Lisa Su 在会议期间表示。AMD 需要扩展其生产 FPGA 和 AI 加速器的 Xilinx 生产网络芯片的 Pensando 获得的技术的小芯片平台。

新闻链接：<https://www.163.com/dy/article/H9VT35I205527A6C.html>

■ 软银调整 ARM 上市计划 伦敦、纽约双挂牌

据彭博社报道，据知情人士透露，软银集团（SoftBank）计划让旗下芯片设计公司 ARM 的部分股票在伦敦证交所上市，但也会赴美挂牌，改变原先只前往美国市场筹资的计划。

知情人士表示，软银正在调整安谋的首次公开发行股票（IPO）计划，在规划上市的股票中，多数股权仍可能在美国证交所上市，目前软银仍未敲定售股的规模和时间表，调整计划仍可能改变。

ARM 于 2016 年被软银收购，不过总部仍位于英国剑桥。在被收购之前，ARM 是英国最重要的科技公司之一，并且大部分业务仍然在那里。ARM 如果只赴美挂牌上市将对英国政府和资本市场造成打击。

新闻链接：https://www.sohu.com/a/557473094_166680

■ 台达电积极扩建产能 兴建郴州新厂

台达电(2308-TW)持续在中国、美国等地扩厂,继先前取得重庆两块土地扩厂后,13日再公告宣布将斥资人民币2.4亿元(约合台币10.59亿元)在湖南省郴州扩建新厂。台达表示,预定兴建的郴州三厂暂估工程款约人民币2.4亿元,其中土建工程约需人民币1.445亿元,为租地委建,未购置土地。为了因应需求,台达电今年资本支出预估将较去年增加1-2成,郑平分析,今、明年的扩产计划,以大陆来看,重庆有一个大生产基地在整地,吴江、芜湖、成州都有新厂兴建中;台湾则有台南厂今年可望搬进去开始运作,并兴建中坊六厂中;泰国厂区目前正在建第八座厂,且第七厂今年将搬进去运作;印度方面,计划将盖四座厂,目前已经盖好了一座,陆续还有三座厂要完工,且研发中心今年会启用;此外,公司并将寻找东欧、美国新的生产基地,持续推升产能。

新闻链接: <https://news.cnyes.com/news/id/4890774>

■ 传长江存储将跳过192层,年底量产232层NAND

6月14日消息:长江存储将跳过原定192层NAND,直接挑战232层NAND,并有望于2022年底量产。2021年长存128层NAND量产,5月有长存已向一些客户交付192层NAND样品,预计2022年底前正式推出。从堆叠层数看,今年5月,美光发布首款232层NAND,并预计今年年底量产,三星预计在今年年底推出200+层的NAND,铠侠目前制程停留在112层,预计2022年底前量产162层;若长存在年底量产232层NAND,将缩小一代制程差距,成功追上国际大厂。

新闻链接: <http://www.icsmart.cn/53846/>

■ 国产浸没式光刻机关键子系统产业化获新突破

集微网消息,据浙江省税务局网站,浙江启尔机电高端集成电路装备迭代至第8代,高精度液体温控误差不超过正负0.001度,零部件中试基地也正式启用,组件试验进展顺利。报道称,启尔机电承担浸没式光刻机浸液控制系统国产化重任。浸液系统则是浸没式光刻机的四大核心部件之一,此前相关技术长期被控制在少数国际巨头手中。

新闻链接: <https://mp.weixin.qq.com/s/25-UI4OVtvh0RL-JzY6K4Q>

■ 华润微入局GaN,收购第三代半导体厂商股份

据SEMI产业投资平台公众号,华润微电子于5月20日收购第三代半导体厂商大连芯冠科技有限公司34.5625%股份,同时后者更名为润新微电子(大连)有限公司,法人变更为华润微电子执行董事、总裁李虹。资料显示,芯冠科技成立于2016年,主要从事第三代半导体硅基氮化镓外延材料及电力电子器件的研发、设计、生产和销售。该公司已建成首条6英寸硅基氮化镓外延及功率器件晶圆生产线,并计划2020年开始持续投入超过10亿元,建设可年产8万片6寸硅基氮化镓外延片及1亿颗硅基氮化镓功率器件规模化生产线,产值约12亿元,净利润约3亿元。

新闻链接: <https://mp.weixin.qq.com/s/95WxVxbA8ggqeOwt9h2U0w>

■ 中科飞测科创板IPO成功过会

6月16日，据上交所科创板上市委2022年第49次审议会议结果显示，深圳中科飞测科技股份有限公司（简称：中科飞测）科创板IPO成功过会。中科飞测是一家国内领先的高端半导体质量控制设备公司，自成立以来始终专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。

新闻链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/chNb9jwEBvmmpHmV81RtfQ>

■ 光刻胶材料商博砚电子等项目签约无锡宜兴

集微网消息，6月17日，江苏省无锡市宜兴市宜城街道举行重大产业项目签约仪式，总投资超30亿元的12只项目集中签约，包括博砚总部项目、元宇宙项目、新能源混合站项目、数字城市项目等，项目涵盖数字经济、科技研发、跨境电商、新能源等产业。其中，博砚总部项目，总投资15亿元，位于东氾新城区域，由江苏博砚电子科技有限公司投资建设，建成后将成为集研发、销售、行政办公功能为一体的总部大楼，助力公司打造世界一流显示面板及半导体集成电路用光刻胶研发能力；

新闻链接：<https://www.163.com/dy/article/HA3DGTGU0511RIVP.html>

■ 光刻胶材料厂商翰亚微电子项目签约落户珠海

集微网消息，6月13日，在“深珠联手 合作共赢”香洲区5.0产业空间招商推介会上，包括中兴系统集成、翰亚微电子、沃信达科技等30个项目签约落地。

公开信息显示，深圳翰亚电子科技有限公司主要从事高档深紫外(KrF & ArF)光刻胶核心原料及其衍生物的研发、生产、销售、产品解决方案及技术支持与服务，核心项目是高档KrF(248nm)深紫外光刻胶核心原材料PHS(第三代)，应用于8~12英寸半导体芯片制造的光刻工艺，制造最小分辨率为100nm的高性能半导体芯片。

新闻链接：

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1735703449976041787&wfr=spider&for=pc>

三、板块跟踪：板块持续震荡，国产替代仍是主旋律

■ 1、分板块跟踪

■ **模拟**：本周模拟板块存在分化，其中上海贝岭上涨15%、希荻微上涨8%、纳芯微上涨5%、富满微上涨2%、其他下跌0%~8%不等。其中上海贝岭上涨主要是个股原因，纳芯微主要是次新股行情，而其他个股持续震荡或继续下跌主要是市场担心板块景气度。我们认为，景气度下行周期中，模拟板块今年将呈现分化行情，持续看好两类公司：1）龙头公司：产品布局更完善，下行周期中仍能凭借先发优势抓住“国产替代”窗口期，并在产能端有所松动时有机会争取更多产能。2）具有特殊定位的公司，如定位于大客户定制化产品，或具有较高壁垒的细分品类。

■ **MCU**：本周MCU板块存在分化，其中中颖电子、乐鑫科技、兆易创新下跌4%~8%不等，国民技术上涨6%、芯海科技上涨1.5%。目前看，中低端消

费类景气度已有所下降，但工业、汽车、中高端消费板块较为坚挺。我们认为，在下行周期中，今年 MCU 板块业绩或存在分化，持续看好两类公司：1) 品类齐全的龙头公司较，持续国产替代。2) 具备特殊定位的 MCU 公司，在细分领域份额快速提升。

- **射频**：本周射频板块存在分化，其中唯捷创芯下跌 7%、麦捷科技上涨 3%、卓胜微微涨。我们认为，目前市场对手机全年销售额的预期极为悲观，股价基本已至底部区间，后续可观望 22Q3、Q4 手机销量是否上修。由于中短期初阶模组上，行业第一梯队与第二梯队的分化已极为清晰，若手机销量恢复唯捷创芯、卓胜微受益明确。
- **功率**：IGBT 指数本周微涨 0.5%，核心标的涨跌延续分化态势。上涨的主要有捷捷微电（7.7%）、新洁能（5.8%）、宏微科技（4.8%）、银河微电（3.0%），下跌的主要有东微半导（-4.6%）、扬杰科技（-4.1%）、时代电气（-3.6%）、华润微（-2.0%），斯达半导微跌 0.9%。整体来看，一方面高估值标的进一步回调，一方面低估值标的估值提升，整体估值水位呈现均值回归态势。市场进入预期 22Q2 业绩的时期，那些预期良好的标的有望获重点关注。
- **设备**：板块延续上周微跌态势，本周跌 1.4%。晶盛机电本周涨 6.5%，拓荆科技涨 1.2%，其余核心标的呈现不同程度下跌：盛美上海跌 7.9%、华峰测控跌 5.9%、北方华创跌 5.7%、中微公司跌 4.3%、华海清科跌 3.6%。设备板块估值整体继续回调，后续关注市场对各家 22Q2 业绩的预期。
- **硅片**：本周半导体材料硅片板块有所波动，其中中晶科技（003026.SZ）上涨 18.78%，中环股份（002129.SZ）上涨 2.32%，沪硅产业-U（688126.SH）下跌 2.12%，立昂微（605358.SH）下跌 4.03%，神工股份（688233.SH）下跌 8.20%。受海外大厂产能持续紧缺影响，下半周硅片板块有所反弹，中晶科技底部反弹明显。海外大厂 SUMCO 的涨价印证全球半导体大硅片的供需持续紧张态势，看好国产半导体硅片厂商在行业紧缺及国产替代背景下的发展机会。
- **光刻胶**：本周光刻胶板块整体上涨，其中华懋科技上涨 6.47%，上海新阳上涨 5.26%，南大光电上涨 4.04%，晶瑞电材上涨 3.39%，彤程新材上涨 0.93%，雅克科技上涨 0.33%。本周光刻胶板块逆势上涨，先前市场对于疫情影响板块公司经营情况的担忧逐渐解除，板块全年维持高景气度，在需求旺盛叠加海外龙头减产造成供给缺口的背景下，光刻胶迎来国产替代机遇窗口期，光刻胶国产替代趋势显著。
- **存储**：本周存储板块出现分化，聚辰股份、国科微、深科技分别上涨 6%、2%、1%，澜起科技下跌 14%，兆易创新、普冉股份、东芯股份、北京君正跌幅 1-4%。大陆存储大市场&低自给率，国产替代空间广阔，建议关注存储细分赛道龙头。
- **制造**：中芯国际 A 股本周跌 1.1%，华虹半导体本周跌 10%。上周据日经亚洲报道，硅片大厂 SUMCO 计划在 2022 年至 2024 年间将晶片制造商的长期合约价格提高约 30%。市场担忧上游核心材料涨价，对晶圆厂成本造成影响。此前两家公司在公开法说会上均表示，2022 年公司会调涨代工价格——此举有望能对冲成本上涨带来的影响。后续关注两家代工龙头的涨价节奏及力度。
- **封测**：板块本周全线上涨，长电科技涨 3.9%、晶方科技涨 3.3%、通富微电涨 2.2%、华天科技涨 2.1%，整体行情呈现较明显的估值修复特征。

前期消费领域需求疲弱，部分封测厂产能利用率下滑，股价随之回调。而后随着消费需求见底，后续展望边际向好，市场博弈消费需求反弹的左侧机会——H2 消费电子旺季来临，封测厂商产能利用率有望反弹，毛利率和业绩趋势转好。

四、重要公告：士兰微拟投资 30 亿元汽车级功率模块封装项目

■ 半导体设备：

拓荆科技：公司于 2022 年 6 月 17 日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，会议审议同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 160,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。

华天科技：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资 3 亿元，在上海自由贸易试验区临港新片区设立全资子公司上海华天集成电路有限公司，该公司主要从事集成电路晶圆和成品测试业务。

■ 功率半导体

华润微：公司于 2022 年 6 月 17 日召开了第二届董事会第一次会议，选举陈小军先生担任公司董事长，任期与公司第二届董事会任期一致。同时聘任：李虹先生为公司总裁、马卫清先生为公司副总裁、姚东晗女士为公司副总裁、段军先生为公司副总裁、李舸先生为公司副总裁兼总法律顾问、吴国屹先生为公司财务总监兼董事会秘书。

士兰微：公司拟通过控股子公司成都士兰半导体制造有限公司（以下简称“成都士兰”）投资建设“年产 720 万块汽车级功率模块封装项目”，项目总投资为 30 亿元。根据成都士兰财务部初步测算，本项目达产后预计新增年销售收入（不含税）277,168 万元，新增年利润总额 30,769 万元，内部收益率（税后）为 14.3%，静态投资回收期（含建设期）为 5.3 年。

五、投资建议

- 持续推荐半导体行业具有大空间/高景气度板块领先企业：
- 1) 功率：下游新能源拉动的需求高景气仍将持续，建议关注扬杰科技、时代电气、斯达半导、士兰微、新洁能、宏微科技等；
- 2) 模拟：龙头厂商料号稳步拓展、持续受益于国产化，建议关注圣邦股份、思瑞浦、希荻微等；
- 3) MCU：看好龙头通过产品结构调整+国产化持续实现业绩高增长，建议关注兆易创新、中颖电子、国民技术等；
- 4) 材料：下游需求火热，国产厂商在下游客户验证周期加快，建议关注立昂微、江丰电子、沪硅产业、兴森科技等；
- 5) 设备：晶圆厂进入开支高峰期，拉动上游设备需求，建议关注北方华

创、芯源微、华峰测控、中微公司等。

图表 17：盈利预测与财务指标

代码	重点公司	现价	EPS				PE			评级
		2022-6-17	2020A	2021A	2022E	2020A	2021A	2022E		
603501.SH	韦尔股份	160	3.1	5.1	6.9	51	31	23	买入	
603986.SH	兆易创新	131	1.9	3.5	4.8	70	38	27	买入	
300327.SZ	中颖电子	50	0.7	1.2	1.7	66	42	28	买入	
688595.SH	芯海科技	71	0.9	1.0	2.0	79	71	36	买入	
300661.SZ	圣邦股份	256	1.8	2.9	3.9	139	88	66	买入	
688173.SH	希荻微	31	-0.4	0.1	0.2	/	437	157	买入	
688536.SH	思瑞浦	536	2.3	5.5	6.6	233	97	81	NA	
300782.SZ	卓胜微	196	6.0	6.5	8.7	33	30	22	买入	
688187.SH	时代电气	59	2.1	1.6	2.0	28	37	29	买入	
600460.SH	士兰微	46	0.1	0.7	0.9	892	68	53	买入	
300373.SZ	扬杰科技	67	0.7	1.5	1.9	90	45	34	买入	
603290.SH	斯达半导	342	1.1	2.0	2.8	303	168	121	买入	
688711.SH	宏微科技	71	0.4	0.5	0.7	198	153	99	NA	
605358.SH	立昂微	60	0.5	0.9	1.4	120	68	42	买入	
300666.SZ	江丰电子	60	0.7	0.7	1.0	91	91	61	买入	
688126.SH	沪硅产业-U	24	0.0	0.1	0.1	683	450	286	买入	
002436.SZ	兴森科技	10	0.4	0.4	0.5	29	25	20	买入	
002409.SZ	雅克科技	54	0.9	1.3	1.8	61	43	31	买入	
300054.SZ	鼎龙股份	19	-0.2	0.2	0.4	/	84	47	NA	
688019.SH	安集科技	221	2.9	1.7	2.9	76	130	75	NA	
688268.SH	华特气体	70	0.9	1.3	1.7	78	55	41	买入	
688106.SH	金宏气体	19	0.4	0.5	0.7	48	37	29	买入	
002371.SZ	北方华创	257	1.1	2.0	3.2	237	126	81	买入	
688037.SH	芯源微	144	0.6	1.1	2.0	248	132	73	买入	
688200.SH	华峰测控	366	3.3	7.5	10.8	112	49	34	买入	
688012.SH	中微公司	121	0.9	1.2	1.4	132	105	88	买入	
688630.SH	芯碁微装	52	0.8	0.9	1.3	67	57	41	买入	
688981.SH	中芯国际	45	0.5	1.3	1.5	82	34	31	买入	
1347.HK	华虹半导体	27	0.4	1.0	1.3	69	26	20	NA	
600584.SH	长电科技	25	0.8	1.7	1.9	31	15	13	NA	
603005.SH	晶方科技	22	1.1	0.9	1.1	19	25	20	NA	
002156.SZ	通富微电	15	0.3	0.7	0.9	57	22	16	买入	
000021.SZ	深科技	11	0.6	0.5	0.7	19	20	17	买入	
002185.SZ	华天科技	9	0.3	0.4	0.5	35	21	17	NA	

来源：wind，中泰证券研究所

注：已覆盖公司采用我们预测值，未覆盖公司采用 wind 一致预期。

注：表中 2020 年 EPS 为期末股本摊薄 ESP。

六、风险提示

- 需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。

投资评级说明:

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上
备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。		

重要声明:

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。